

SEMI G34-89

仕様 自動アセンブリ用のリードフレームを含んだ CER-PACK パッケージ構造

免責事項: この SEMI スタンダードは、投票により作成された英語版が正式なものであり、日本語版は日本の利用者各位の便宜のために作成したものです。万が一英語と日本語とに差異がある場合には英語版記載内容が優先されます。

1 序文

この仕様はプリントワイヤボードへの自動組立て用 Cer-pack パッケージ構造のための標準要求事項に関するものであり、リードフレームを含めたパッケージ構造の受入れ基準をも含むものである。

2 参考文献

2.1 この仕様は下記の規格を参照している。

MIL-STD-883 — Test Methods and Procedures for Microelectronics

2.2 関連規格

MIL-M-38510 — General Specification for Microcircuits

3 定義

バリ(burr) — 部品の縁の部分にはみ出して付着した母材片

欠け(chip) — パッケージの表面または縁の部分のセラミック部の欠けで、パッケージ全体にひろがるものではない。欠けの大きさは、設計投影図の長さ、幅、及び深さにより決まる(図 1 参照)。

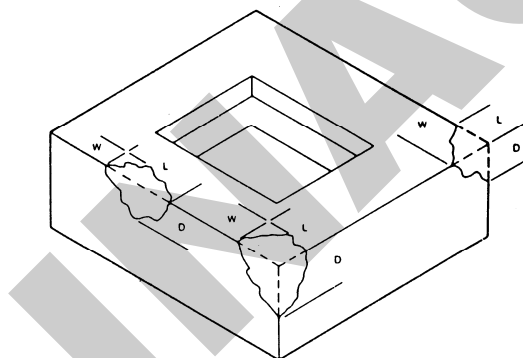


図 1

欠け

クラック(crack) — パッケージの表面に広がる割れ目又は裂け目。パッケージの厚さ全体にわたるか否かは問わない。

臨界封止領域(critical seal area) — キャビティのコーナーからセラミックの縁までの最短線によって区切られる領域(図 2 参照)

臨界封止路(critical seal path) — ダイ取付けくぼみからセラミックの縁までの臨界封止領域にまたがる公称設計距離

フィン(fin) — 細く縁どられたセラミックの端又はコーナーからの突出物

ガラス流れ(glass flow) — 拡大率 10 倍で観察される封着ガラスの付着メッシュ

非臨界封止領域(non-critical seal area) — 封止面の臨界領域の外側にくる部分(図 2 参照)

はみ出し(overhang) — セラミックからのガラスの水平方向の伸張(図 3 参照)

突起(projection) — 母材自体の表面の飛び出た部分

プルバック(pullback) — 封止領域におけるガラス又はメタライゼーションのない状態(図 3, 4, 及び 5 参照)

垂れ下がり(rundown) — セラミックからのガラスの垂直方向の伸張(図 3 参照)

封止領域(seal area) — 気密封止をもたらすベースおよびキャップの封止用に定められた外形領域(図 5 参照)

ボイド(void) — セラミック表面上の指定メタライズ又はガラス領域からのメタライゼーション及びガラスの欠損

注: SEMI による書面での了承なき場合は、本書の全部もしくは一部の転載を禁じる。

©Semiconductor Equipment and Materials International (<http://www.semi.org/>)

©SEMI ジャパン 〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-7-15 健和ビル 7 階

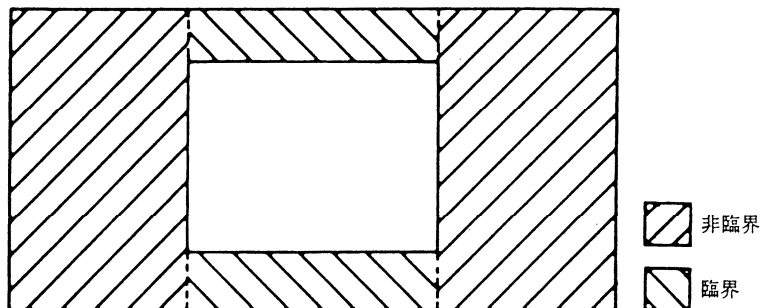


図 2
臨界及び非臨界封止領域

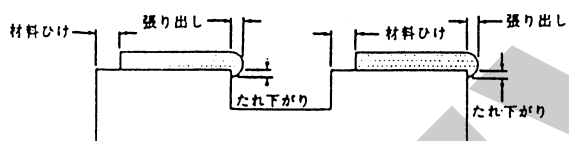


図 3
ガラスの位置ずれ

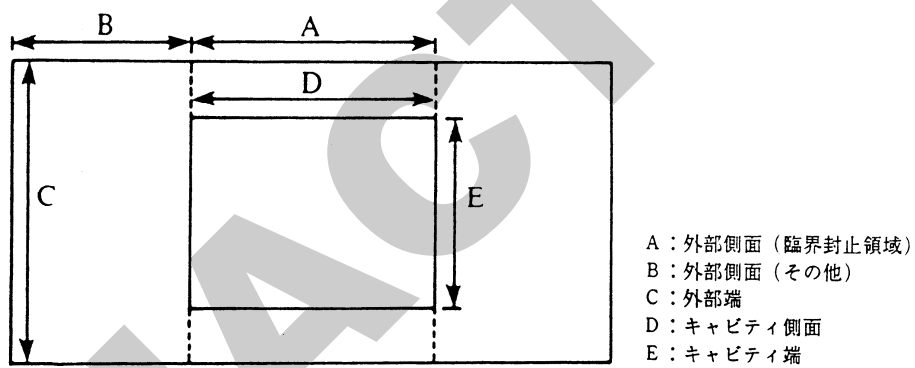


図 4
材料ひけ測定領域

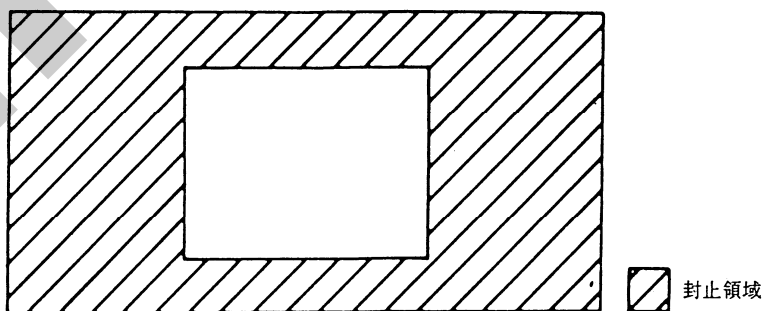


図 5
封止領域